

# 2009-2010年半导体产业市场分析及投资预测报告

## 报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2009-2010年半导体产业市场分析及投资预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/3214232142.html>

报告价格：电子版: 7300元 纸介版：7800元 电子和纸介版: 8300

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

### 报告目录

#### 第一章 中国半导体市场 8

##### 第一节 中国半导体产业运行分析 8

###### 一、2008年我国半导体市场现状 8

###### 二、2008年全球半导体市场现状 9

###### 三、中国半导体市场在全球中的地位 12

###### 四、中国半导体市场发展趋势 13

##### 第二节 中国半导体设备和材料市场分析 15

###### 一、国内外半导体材料发展分析 15

###### 二、我国半导体制造材料市场 16

###### 三、全球及中国半导体设备市场分析 17

##### 第三节 集成电路 18

###### 一、我国IC芯片产业市场产能及布局 18

###### 二、2008年中国集成电路市场分析 20

###### 三、国内外集成电路市场发展现状及差距 24

##### 第四节 电子元器件市场 27

###### 一、中国电子元件行业发展现状 27

###### 二、我国电子元器件发展渠道 28

###### 三、我国电子元器件市场发展趋势 29

##### 第五节 半导体分立器件市场 30

#### 第二章 晶圆制造产业简介 32

##### 第一节 晶圆制造工艺简介 32

##### 第二节 全球晶圆产业及主要厂商简介 35

###### 一、全球晶圆产业发展现状 35

###### 二、全球晶圆产业市场规模及主要厂商 36

###### 三、全球晶圆产品市场结构 36

###### 四、全球晶圆产能预测 38

##### 第三节 中国半导体产业政策环境 41

###### 一、政策背景及进展情况 41

###### 二、《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》内容 42

###### 三、财税[2008]1号文件发布软件企业所得税优惠政策 48

##### 第四节 中国晶圆制造业现状及预测 49

###### 一、全球晶圆代工市场现状 49

二、中国晶圆代工市场现状	52
三、从晶圆设备支出看全球及中国晶圆产能	55
第三章 封测产业简介	63
第一节 封测工艺简介及未来发展趋势	63
一、先进封装技术的发展趋势	63
二、IC测试技术发展趋势：	69
第二节 全球IC封测市场简介	71
第三节 全球IC封测产业格局	72
第四节 中国IC封测产业发展历史及现状	74
一、中国IC封测产业发展历史	74
二、2008年中国IC封测产业发展状况	75
三、我国半导体封测产业市场竞争形势	79
第五节 中国IC封测产业格局	82
第六节 中国IC封测产业预测	84
第七节 中国二手半导体设备市场现状	86
第八节 二手IC设备制造商格局	88
第九节 二手IC设备进口相关政策	89
第四章 半导体设备厂商	91
第一节 Applied Materials	93
第二节 Tokyo Electron Limited	95
第三节 ASML	96
第四节 KLA-Tencor	97
第五节 尼康精机公司	98
第六节 Dainippon Screen	99
第七节 Novellus	99
第八节 Lam Research	101
第五章 晶圆厂商	102
第一节 中芯国际	102
第二节 上海华虹NEC电子有限公司	104
第三节 上海宏力半导体制造有限公司	105
第四节 华润微电子	105
第五节 上海先进半导体	106
第六节 和舰科技（苏州）有限公司	107
第七节 BCD半导体制造有限公司	108
第八节 方正微电子有限公司	109

第九节 中宁微电子公司	109
第十节 南通绿山集成电路有限公司	109
第十一节 纳科(常州)微电子有限公司	110
第十二节 珠海南科集成电子有限公司	110
第十三节 康福超能半导体(北京)有限公司	113
第十四节 科希-硅技半导体技术第一有限公司	113
第十五节 光电子(大连)有限公司	114
第十六节 西安西岳电子技术有限公司	115
第十七节 吉林华微电子股份有限公司	116
第十八节 丹东安顺微电子有限公司	117
第十九节 敦南科技	117
第二十节 福建福顺微电子	118
第二十一节 杭州立昂	119
第二十二节 杭州士兰微电子	119
第二十三节 宁波中纬	120
第二十四节 绍兴华越微电子	121
第二十五节 深爱半导体(sisemi)	122
第二十六节 赛米微尔(Semeware)	123
第二十七节 茂德科技	123
第二十八节 南京高新半导体公司	123
第二十九节 上海汉升科集成电路	123
第六章 封测厂商	124
第一节 日月光	125
第二节 矽品	128
第三节 菱生精密	128
第四节 京元电子	129
第五节 超丰电子	130
第六节 宁波明昕电子	130
第七节 宏盛科技	131
第八节 威宇科技GAPT	132
第九节 巨丰电子	133
第十节 通用半导体	133
第十一节 瀚霖电子	134
第十二节 捷敏电子	134
第十三节 凯虹电子	136

- 第十四节 北京三菱四通微电子公司 136
- 第十五节 南茂 136
- 第十六节 Intel 137
- 第十七节 摩托罗拉 (Motorola) 139
- 第十八节 飞利浦 (Philips) 141
- 第十九节 国家半导体 (National Semiconductor) 141
- 第二十节 超微 (AMD) 142
- 第二十一节 安靠科技 (Amkor Technology) 142
- 第二十二节 新科金朋(STATS ChipPAC) 143
- 第二十三节 三星电子 (SAMSUNG) 143
- 第二十四节 KEC 144
- 第二十五节 新加坡联合科技 (UTAC) 145
- 第二十六节 三洋半导体 (蛇口) 有限公司 145
- 第二十七节 东莞长安乐依文半导体装配测试厂 (ASAT) 145
- 第二十八节 清溪三清半导体 146
- 第二十九节 上海新康电子 146
- 第三十节 上海松下半导体 147
- 第三十一节 上海纪元微科微电子 147
- 第三十二节 瑞萨半导体 (苏州) 有限公司 (原日立半导体 (苏州) 有限公司) 148
- 第三十三节 英飞凌科技(苏州)有限公司 148
- 第三十四节 矽格微电子 (无锡) 有限公司 149
- 第三十五节 南通富士通微电子 150
- 第三十六节 瑞萨四通集成电路 (北京) 有限公司 150
- 第三十七节 深圳赛意法电子 151
- 第三十八节 天水华天科技股份有限公司 (原甘肃永红) 151
- 第三十九节 浙江华越芯装电子股份有限公司 152
- 第四十节 骊山微电子 152
- 第四十一节 汕头华汕电子器件有限公司 153
- 第四十二节 华联电子有限公司 153
- 第四十三节 上海华旭微电子 154
- 第四十四节 无锡华润安盛科技有限公司 155
- 第四十五节 中电华威电子 (原连云港华威电子) 155
- 第四十六节 江苏长电科技股份有限公司 156
- 第四十七节 成都亚光电子 156
- 第四十八节 万立电子 (无锡公司) 157

第四十九节 桂林斯壮微电子有限责任公司（南方电子有限公司） 157

第五十节 乐山-菲尼克斯 158

第五十一节 珠海南科电子有限公司 159

图表目录：

图表 1 2007-2011年我国半导体市场增速走势 8

图表 2 2003-2008年我国半导体行业的市场结构 8

图表 3 2008年中国半导体市场品牌结构 9

图表 4 全球半导体市场需求结构 10

图表 5 1990-2009年全球半导体市场增长走势 10

图表 6 2008年半导体销售收入排名 11

图表 7 2008-2012年中国集成电路市场预测 14

图表 8 2007-2008年全球主要国家半导体材料增长情况 15

图表 9 2008年中国芯片制造前十大企业销售额 19

图表 10 2003 - 2008年中国集成电路市场销售额规模及增长率 21

图表 11 2008年中国集成电路市场应用结构 21

图表 12 2008年中国集成电路市场产品结构 22

图表 13 2008年中国集成电路市场品牌结构 23

图表 14 2008 - 2012年中国集成电路市场规模及增长率预测 24

图表 15 2002-2008年全球与中国集成电路市场增速对比 25

图表 16 2005-2009年世界集成电路销售统计预测 25

图表 17 目前中国主要电子元器件产品产量占全球的比重 27

图表 18 2007年中国分立器件市场结构 30

图表 19 目前全球前10大硅片生产商 36

图表 20 2008年全球晶圆厂设备采购方面的支出 40

图表 21 2007-2008年世界主要高纯多晶硅制造商产量和生产能力一览表 41

图表 22 2002 - 2007年全球Foundry厂商销售额（按类别划分） 49

图表 23 2002 - 2007年全球Foundry生产线销售额结构（按尺寸划分） 50

图表 24 2002 - 2007年全球Foundry生产线销售额结构（按线宽划分） 50

图表 25 2002 - 2007年全球Foundry产能及实际产量情况 51

图表 26 2007年全球TOP10 Pure-play Foundry企业 51

图表 27 2002 - 2007年中国Foundry产业销售额规模及增长 52

图表 28 2002 - 2007年中国Foundry产能及实际产量情况 53

图表 29 2002 - 2007年中国Foundry生产线产能结构（按线宽划分） 54

图表 30 2007年中国主要Pure-play Foundry企业 54

图表 31 2008 - 2011年全球及中国晶圆代工市场规模预测 55

- 图表 32 2007-2008年全球主要国家用于晶圆厂投资变动情况 56
- 图表 33 2007-2008年全球主要国家用于晶圆厂装备投资的变动情况 57
- 图表 34 2000-2008年全球不同国家和地区芯片制造份额变动情况 58
- 图表 35 2000-2008年全球主要国家晶圆相对产能增长情况 60
- 图表 36 2008年全球300mm晶圆厂产能预测 61
- 图表 37 2000-2008年量产晶圆厂产能走势 61
- 图表 38 半导体封装形式发展趋势 64
- 图表 39 引线键合 64
- 图表 40 倒装芯片 65
- 图表 41 凸点生产-前端工艺 65
- 图表 42 凸点生产-后端工艺 66
- 图表 43 硅片键合剖面图 66
- 图表 44 焊盘间距变化趋势 67
- 图表 45 引线键合与倒装芯片发展趋势 68
- 图表 46 各种内部连接方式在新型封装中的应用 69
- 图表 47 目前全球前十大IC 封测企业 72
- 图表 48 台湾地区主要封测厂产能一览表 74
- 图表 49 2001-2008年中国集成电路封装测试业销售收入 76
- 图表 50 大陆现阶段或短期内具备量产规模的外资封测企业 79
- 图表 51 现阶段外资在我国西部投资的封装企业 80
- 图表 52 封装技术演进历程 81
- 图表 53 2008年中国IC封装测试业前十大企业销售额 83
- 图表 54 2008年前十大半导体设备厂商排名 92
- 图表 55 珠海南科集成电子有限公司IC生产流程图 112

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/3214232142.html>